

苏州珂玛材料科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况说明

深圳证券交易所：

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用的情况说明如下：

一、募集资金投资项目概况

（一）本次募集资金投资项目资金需求

公司本次发行的股票数量7,500万股。公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的投资项目及主营业务发展所需的营运资金。

根据本公司的发展计划，本次发行所募集的资金在扣除发行费用后的使用计划如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|----|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 先进材料生产基地项目 | 44,018.30 | 35,000.00 |
| 2 | 泛半导体核心零部件加工制造项目 | 15,000.00 | 12,000.00 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 34,711.22 | 28,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 合计 | | 108,729.52 | 90,000.00 |

（二）募集资金投资项目的批准、核准情况

先进材料生产基地项目已取得江苏省苏州高新区（虎丘区）行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案号：苏高新项备[2022]88号），并已获得苏州市生态环境局出具的《关于对苏州珂玛材料科技股份有限公司先进材料生产基地项目环境影响报告表的批复》（苏环建[2022]05第0099号）。

泛半导体核心零部件加工制造项目已取得四川省彭山区发展和改革局出具

的《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备[2111-511422-04-01-939501]FGQB-0208号），并已获得眉山市生态环境局出具的《关于四川珂玛材料技术有限公司泛半导体核心零部件加工制造项目环境影响报告书的批复》（眉市环建函[2022]60号）。

研发中心建设项目已取得江苏省苏州高新区(虎丘区)行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案号：苏高新项备[2022]48号），并已获得苏州市生态环境局出具的《关于对苏州珂玛材料科技股份有限公司研发中心建设项目环境影响报告表的批复》（苏环建[2022]05第0077号）。

（三）募集资金管理制度

公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储及使用管理、募集资金投资项目的管理与监督等进行了详细规定。根据该制度规定，公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金，应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、对发行人未来经营战略的影响

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务投向科技创新领域。为匹配公司先进陶瓷产能扩张，公司拟投资建设先进材料生产基地项目，项目将进一步提高产线生产效率，并实现产品多样化；为拓展表面处理业务下游半导体领域客户，公司拟建设泛半导体核心零部件加工制造项目，项目将新建成对半导体零部件加工和阳极氧化产能；为保持公司在行业内的核心竞争优势，支撑公司未来深入技术创新，公司拟投资建设研发中心建设项目，将进一步加大在新产品和新技术领域的科技创新研发。补充流动资金将能够有效补充运营资金，为公司持续经营和发展提供资金保障。

二、募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目为“先进材料生产基地项目”、“泛半导体核心零部

件加工制造项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”，具体情况如下：

（一）先进材料生产基地项目

1、项目建设概况

本项目实施主体为珂玛科技，项目总投资44,018.30万元，拟使用本次发行的募集资金35,000.00万元。项目建成投产后，公司将进一步扩大先进陶瓷产能，生产线将更加集中化，生产效率将得到进一步提升，预计将逐步建成覆盖氧化铝、氧化锆、碳化硅、氮化铝、氮化硅、氧化钪和氧化钛陶瓷等产品的成熟产线。

2、项目投资概算

本项目建设拟投资44,018.30万元，包括工程建设费用41,071.68万元、预备费821.43万元、铺底流动资金2,125.19万元。

3、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

| 序号 | 项目 | T1 | | | | T2 | | | | T3 | | | |
|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | 项目准备及备案 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | 土建施工及装修 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 3 | 设备采购及安装 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 4 | 人员招聘及培训 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 5 | 投入生产 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

4、项目选址

本项目选址位于苏州市虎丘区严山路和新钱路交接口，公司已取得苏(2022)苏州市不动产权第5011986号不动产权证书。

（二）泛半导体核心零部件加工制造项目

1、项目建设概况

本项目实施主体为四川珂玛，项目总投资15,000.00万元，拟使用本次发行的

募集资金12,000.00万元。项目建成投产后，将拥有包括先进陶瓷、石英、金属等半导体相关零部件新品加工共计5万件/年的产能以及半导体设备零部件阳极氧化共计20万件/年的产能。

2、项目投资概算

本项目建设拟投资15,000.00万元，包括工程建设费用13,844.18万元、预备费276.88万元、铺底流动资金878.94万元。

3、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

| 序号 | 项目 | T1 | | | | T2 | | | | T3 | | | |
|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | 项目准备及备案 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 土建施工及装修 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 设备采购及安装 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 人员招聘及培训 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 投入生产 | | | | | | | | | | | | |

4、项目选址

本项目选址位于四川彭山经济开发区创新三路西段1号，公司已取得川(2022)彭山区不动产权第0004676号不动产权证书。

(三) 研发中心建设项目

1、项目建设概况

本项目实施主体为珂玛科技，项目总投资34,711.22万元，拟使用本次发行的募集资金28,000.00万元。

2、项目投资概算

本项目建设拟投资34,711.22万元，包括工程建设费用29,074.63万元、研发费用4,955.99万元、基本预备费680.61万元。

3、项目实施进度安排

本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：

| 序号 | 项目 | T1 | | | | T2 | | | | T3 | | | |
|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | 项目准备及备案 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 土建施工及装修 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 设备采购及安装 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 人员招聘及培训 | | | | | | | | | | | | |

4、募集资金运用涉及的土地使用权情况

本项目选址位于苏州市虎丘区严山路和新钱路交接口，公司已取得苏(2022)苏州市不动产权第5011986号不动产权证书。

(四) 补充流动资金

报告期内，公司经营规模持续增长，使公司对日常运营资金的需求不断增加；同时，先进陶瓷与表面处理行业是典型的技术密集型行业，公司需要通过持续的技术研发投入以保证竞争优势。为保证公司发展规划的顺利实施，优化财务结构，加强财务抗风险能力，公司以实际运营情况为基础，结合未来发展规划，拟将本次募集资金中15,000.00万元用于补充与主营业务相关的流动资金。

三、募集资金投资项目与公司现有业务及发展战略之间的关系

本次募集资金投资项目与公司现有主营业务紧密相关。公司主要从事先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务的具体关系如下：

| 序号 | 项目名称 | 是否与主营业务密切相关 | 具体关系 |
|----|-----------------|-------------|----------------------------|
| 1 | 先进材料生产基地项目 | 是 | 用于先进陶瓷材料零部件的生产 |
| 2 | 泛半导体核心零部件加工制造项目 | 是 | 用于表面处理的服务实施和半导体设备零部件新品加工制造 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 是 | 用于先进陶瓷材料零部件、表面处理的研发 |
| 4 | 补充流动资金 | 是 | 用于先进陶瓷材料零部件、表面处理的生产、研发、销售 |

本次募集资金项目是公司在现有主营业务的基础上，结合未来市场需求对现有产品的推广升级和关键核心技术的延伸发展，与公司现有主营业务紧密相关。公司一直专注于先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。本次募集资金投资项目的实施将提升公司先进陶瓷与表面处理的生产能力，有利于公司市场份额和行业地位的进一步提升。同时，研发中心建设项目的实施将进一步提升公司的研发和技术创新能力，推动关键领域产品和服务突破。

五、未来战略规划

目前，我国先进陶瓷行业处于提升国际竞争力阶段。公司未来将把握泛半导体行业快速发展的战略机遇，紧跟行业发展趋势，通过自主研发、合作研发持续提升公司技术实力，不断突破中高端产品技术瓶颈，推动先进陶瓷国产替代进程，为客户创造价值。在泛半导体领域，公司将持续增加研发及产业化投入，进一步加强产业链“卡脖子”产品布局，重点研发突破12寸静电卡盘、超高纯碳化硅套件，并进一步完善陶瓷加热器、8寸静电卡盘产品。在泛半导体以外领域，公司将提升完善材料体系，探索材料跨领域应用关联技术，推动下游应用领域向医疗器械、半导体封装、电子通讯、汽车、化工环保和新能源等进一步扩展。在充分挖掘现有客户需求的基础上，公司将进一步加强海外市场开拓，尤其是加大国际领先半导体客户开发力度。公司将在未来适当发展阶段向上游粉末原材料环节延伸布局，并联合供应商加强研究开发。

公司表面处理业务未来将继续加强综合服务能力，进一步巩固熔射细分领域优势，并保持与先进陶瓷业务的密切协同，共同为客户创造价值。在泛半导体领域，显示面板表面处理将重点推动与应用材料在CVD设备表面处理业务的合作，并推动业务发展和市场开拓；四川生产基地二期建成投产后，可大幅提升公司先进制程半导体设备零部件的表面处理产能，继续拓展下游客户服务范围；四川生产基地未来规划将引入硅、石英和金属零部件制造，围绕加工、后端处理进行相关业务布局。在泛半导体以外领域，公司规划在未来更长期扩展民用航空、新能源和工业耐磨件等领域的表面处理服务，推动下游应用领域向更大市场空间延伸。

公司未来将持续投入资金和人力资源，加强研发技术团队建设，扩大先进陶

瓷与表面处理生产能力。通过加强内部管理，不断提升产业化运营能力，提高公司在国内外的市场占有率。公司未来将继续秉持“以持续的产品和技术创新，构建全面的先进陶瓷材料体系，创造代表先进陶瓷顶尖科技的产品和服务”的发展理念，不断巩固竞争优势和提升市场地位，力争成为国际一流的先进陶瓷及表面处理服务企业。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司关于募集资金的具体运用情况的说明》之盖章页）

苏州珂玛材料科技股份有限公司



2024年7月26日